

Title (en)
Primer for metallization.

Title (de)
Primer zum Metallisieren von Substratoberflächen.

Title (fr)
Couche de base pour métallisation.

Publication
EP 0485839 A2 19920520 (DE)

Application
EP 91118731 A 19911104

Priority
DE 4036591 A 19901116

Abstract (en)
Primers consisting essentially of a film-former or matrix-former, an additive, an ionogenic and/or colloidal noble metal, a filler and a solvent are suitable for coating substrate surfaces for subsequent chemical (electroless) metallisation.

Abstract (de)
Primer, bestehend im wesentlichen aus einem Film- bzw. Matrixbildner, einem Additiv, einem ionogenen und/oder kolloidalen Edelmetall, einem Füllstoff und einem Lösungsmittel, eignen sich zum Beschichten von Substratoberflächen zur anschließenden chemischen Metallisierung.

IPC 1-7
C23C 18/28

IPC 8 full level
C08J 7/04 (2006.01); **C09D 5/38** (2006.01); **C09D 175/00** (2006.01); **C09D 175/04** (2006.01); **C23C 18/18** (2006.01); **C23C 18/28** (2006.01); **G12B 17/02** (2006.01); **H05K 9/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23C 18/28 (2013.01 - EP US)

Cited by
CN109694685A; WO9909794A1

Designated contracting state (EPC)
BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0485839 A2 19920520; **EP 0485839 A3 19930224**; **EP 0485839 B1 19950104**; CA 2055352 A1 19920517; CA 2055352 C 19991026; DE 4036591 A1 19920521; DE 59104146 D1 19950216; JP H04365872 A 19921217; US 5378268 A 19950103

DOCDB simple family (application)
EP 91118731 A 19911104; CA 2055352 A 19911113; DE 4036591 A 19901116; DE 59104146 T 19911104; JP 32237691 A 19911112; US 78895791 A 19911107